

114 年度工具機與半導體商機與技術交流媒合會

目的：

我國工具機產業具備完整產業鏈與製造實力，隨半導體產業蓬勃發展，相關設備與零組件需求增加。為協助業者切入半導體應用市場，經濟部產業發展署將辦理專題分享與一對一媒合活動，包含說明半導體加工需求、合作經驗分享與工具機技術能量，藉以促進工具機與半導體周邊產業跨域合作。活動並配合明年度政府補助資源說明，鼓勵業者投入研發與加工能量，帶動產業鏈共同成長，歡迎業界先進報名參與。

時間：114 年 11 月 4 日(星期二)下午 14:00~17:00

地點：財團法人精密機械研究發展中心 2F(智機會議室)(台中市西屯區工業區 37 路 27 號)

指導單位：經濟部產業發展署

主辦單位：財團法人金屬工業研究發展中心

執行單位：財團法人精密機械研究發展中心

協辦單位：台灣工具機暨零組件工業同業公會、臺灣機械工業同業公會

報名網址：<https://www.pmc.org.tw/tw/traning/show.aspx?num=235&kind=5>



議程：

項次	時間	議程	備註
1	13:30~14:00	活動報到	
2	14:00~14:10	開場致詞	產業發展署 代表 主辦單位代表
3	14:10~14:20	和碩企業半導體加工應用能量與需求分享	和碩企業 張維中總經理
4	14:20~14:30	新虎將工具機整機廠能量說明	新虎將 王仁佑副總經理
5	14:30~14:40	大型龍門加工機整合數位化取得電子業加工訂單經驗交流	讚鋒機械廠 謝賀傑特助
6	14:40~14:50	法人驗證與半導體相關輔導能量說明	精機中心 林成興副處長
7	14:50~15:00	工具機切入半導體領域策略與資源說明	金屬中心 楊庭鈞專案經理
8	15:00~15:10	中場休息暨媒合場地安排(註 1)	精機中心
9	15:10~17:00	廠商媒合洽談(註 2) 1. 和碩企業(張總經理)-半導體零件加工設備需求。(媒合洽談區 1) 2. 翔名科技(產品工程部劉經理)-半導體零件加工設備(平面磨床及自動化)需求。(媒合洽談區 2)。 3. 新虎將(王副總經理)-工具機合作洽談。(媒合洽談區 3) 4. 讚鋒機械廠(謝特助)-高階產品加工合作洽談。(媒合洽談區 4) 5. 其他有媒合需求業者可報名時聯繫 PMC	
10	17:00	賦歸	

註 1:若有新增廠商分享加工應用需求或設備能量議題，將以此時段進行安排。

註 2:廠商媒合洽談地點為 2F 智機戰情室或其他辦公室，進行小組細部洽談。

活動諮詢人員：財團法人精密機械研究發展中心 張乃文工程師

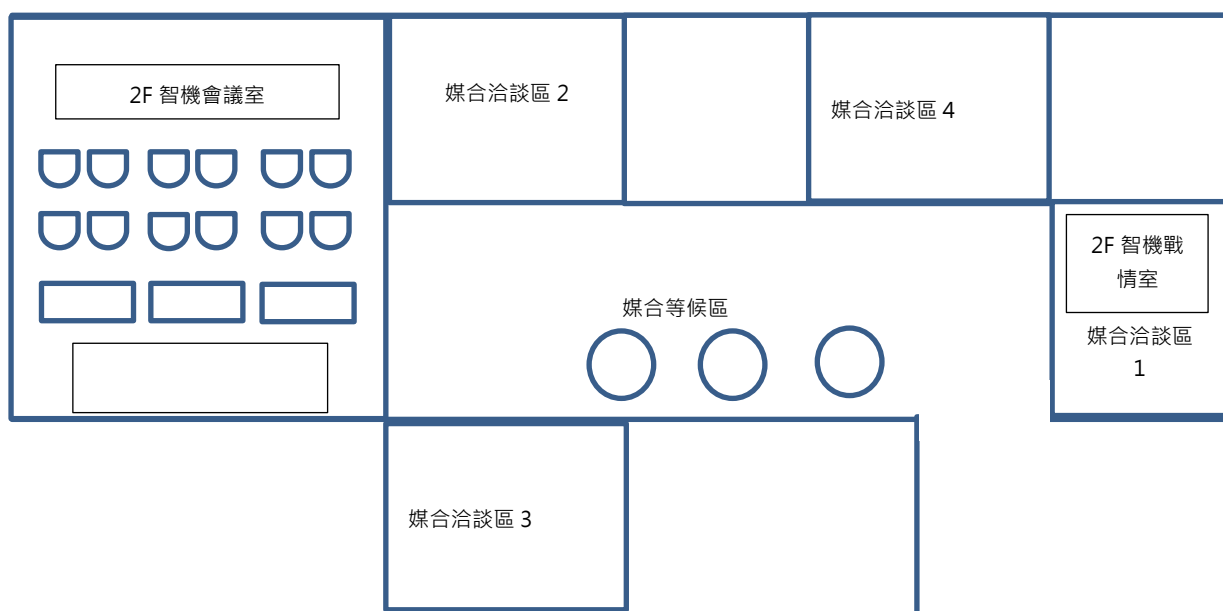
電話:04-23599009-396 email: e9706@mail.pmc.org.tw

活動路線指引

1. 搭乘計程車至「財團法人精密機械研究發展中心」下車，費用依公定跳表費率計算。
2. 開車前往財團法人精密機械研究發展中心(台中市工業區 37 路 27 號，活動當日中心預留 30 個停車位。)



精機中心位置地圖



精機中心 2F 智機會議室與媒合洽談區位置示意圖